



Metal Powders for Additive Manufacturing

金属積層造形用 高品位パウダー

製品ラインナップ

Powder Bed FusionとDirect Energy DepositionそれぞれのAMプロセスに対応した高品位パウダーのご提供が可能です。ご注文は10kg(一部30kg)から受け賜りますのでお気軽にご相談ください。また、本リストに含まれていない金属パウダーにつきましてもご対応できる場合がございます。お気軽に弊社までお問合せください。

ニッケル系パウダー / Nickel Based Powders

対応プロセス			製品名(同等材)
SLM	EBM	DED	
●	●	●	CT PowderRange 718 (インコネル718)
●			CT PowderRange 247LC (CM-247LC)
●	●	●	CT PowderRange 625 (インコネル625)
●			CT PowderRange X (ハステロイ X)

Fe系パウダー / Iron Based Powders

対応プロセス			製品名(同等材)
SLM	EBM	DED	
●			CT PowderRange 155 (15-5PH, PH1)
●			CT PowderRange 174 (17-4PH, SUS630)
●	●	●	CT PowderRange 304 (SUS304)
●	●	●	CT PowderRange 316 (SUS316L)
●			CT PowderRange H13 (SKD61)
●			CT PowderRange M300 (18Ni300, マルエージング鋼)

アルミ系パウダー / Aluminium Based Powders

対応プロセス			製品名(同等材)
SLM	EBM	DED	
●			AlSi7Mg (アルミ合金鋳物材)
●			AlSi10Mg (アルミ合金鋳物材)
●			Scalmalloy (Al-Mg-Sc合金)

コバルト系パウダー / Cobalt Based Powders

対応プロセス			製品名(同等材)
SLM	EBM	DED	
●			CT PowderRange CoCr (MP1 / ISO5832-4 / ISO5832-12)

チタン系パウダー / Titanium Based Powders

対応プロセス			製品名(同等材)
SLM	EBM	DED	
●	●	●	CP Ti Gd1 (ISO 5832-2)
●	●	●	CT PowderRange Ti64 (6-4チタングレード23 / ISO 5832-3)

その他 / Other Alloys (30kg~)

対応プロセス			製品名(同等材)
SLM	EBM	DED	
●		●	WC (タングステンカーバイド)
●			Cp Cu (純銅)
●			Cp Ta (純タンタル)
●			Cp W (純タングステン)

Powder Analysis for Additive Manufacturing

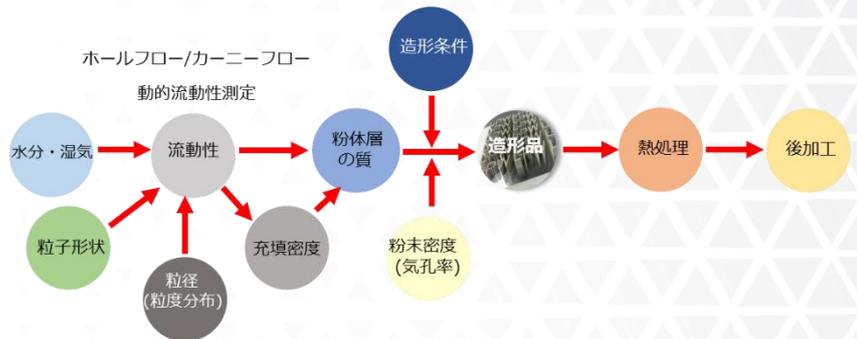
AM用パウダー分析試験

AM用金属パウダーの物理的分析を受託いたします。

金属パウダーはAM製品において品質を決定する重要な項目の一つです。その分析を行う事は安定した生産に欠かせません。是非、LPWテクノロジー日本の分析試験サービスをご活用ください。



【粉末特性と3D造形製品品質の関係】



【パウダー分析試験一覧】

試験項目		試験方法	備考
粒径		レーザー回折式粒度分布測定	回折パターンの違いから粒子の体積を求め、粒度分布を測定
		自動画像解析による粒度分布測定	粒子1個1個をカメラで撮像し、粒径を求め粒度分布を測定
粒子形状		自動画像解析	アスペクト比、面積円形度などの情報も自動測定可能
		SEM(走査型電子顕微鏡)	形状のみ評価
流動性		ホルフロー/カーニーフロー	自由落下による流動性評価
		安定性・流速変化試験	粉末を流動させた状態での流動性評価
水分・湿気		水分計	粉末を加熱し気化した水分を電気化学的に測定
密度	充填密度	かさ密度	自由落下させた状態での空隙を含んだ密度の測定
		タップ密度	粉末に上下運動(タップ)を与え、得られる密度の測定
	粒子密度	定容積膨張法	見かけ密度(粒子内空孔を含む)の測定
コンタミネーション		EDXによる組織分析	特性X線検知による簡易的な元素分析

Contact Us